

导热凝胶 Thermal Gel

【产品概述 Product Description】

SE150AB 是一种柔软的双组份硅树脂基导热缝隙填充材料，具有高导热率、低界面热阻及良好的触变性，是大缝隙公差场合应用的理想材料。它填充于需冷却的电子元件与散热器/壳体等之间，使其紧密接触、减小热阻，快速有效地降低电子元件的温度，从而延长电子元件的使用寿命并提高其可靠性。SE150AB 可通过手工方式或点胶设备来进行涂装，固化后为弹性体，可以保护元器件。

【产品图示 Product Illustration】



【典型应用/Applications】

- 硬盘、手机
- 光学精密设备
- 笔记本电脑
- 移动及通讯设备
- 汽车发动机控制设备
- 高端工控及医疗电子等领域

| 特性参数 SE150AB | | | |
|-------------------------|------------------------|--------|-----------------|
| 产品性能 | 测试结果 | | 测试标准 |
| 混合前 | A 组分 | B 组分 | |
| 颜色 | 白色 | 粉红色 | 目视 |
| 粘度 (mPa. s) | 250000 | 250000 | ASTM D2196 |
| 密度 (g/cm ³) | 2.5 | 2.5 | 氦气真密度法 |
| 混合比例 | 1:1 | | N/A |
| 在架寿命@25°C (月) | 6 | 6 | N/A |
| 混合后性能 | | | |
| 颜色 | 粉红色 | | 目视 |
| 体积电阻 | >10 ¹³ Ω cm | | ASTM D257 |
| 导热系数 | 1.5W/m-K | | ASTM D5470 |
| 介电击穿强度 | >200VAC/mil | | ASTM D149 |
| 介电常数 | 5.5 | | ASTM D150 |
| 最小介面厚度 | 0.09mm | | N/A |
| 使用温度 | -50~200°C | | N/A |
| 硅小分子析出 D3~D12 含量 | <300PPM | | GB/T 27843-2011 |
| 热膨胀系数 | 175ppm/K | | ASTM E831 |
| 阻燃性 | V-0 | | UL |
| 表干时间@25°C (Min) | 20 | | N/A |
| 完全固化时间 | | | |
| 25°C (H) | 8 | | N/A |
| 100°C (min) | 15 | | N/A |
| 固化后硬度 (Shore oo) | 40~90° | | ASTM D2240 |
| RoHS | PASS | | IEC 62321 |
| Halogen | PASS | | EN14582 |
| REACH) | PASS | | EN14372 |

使用 ASTM D5470 测试夹具。记录值包括界面热阻。这些数值仅供参考。实际应用性能直接关系到所施加的表面粗糙度、平整度和压力。

注：厚度公差为±10%，硬度公差为±5°，颜色/厚度/硬度均可按客户需求调试。

【储存&运输】 贮存于通风、阴凉、干燥处，不要接触明火。本产品无毒，按非危险品贮存及运输

【包装】 50cc 或 400cc。

【有效期】 本产品有效期为 12 个月

【安全】 请参阅本公司《材料安全性能数据 (MSDS)》

以上这些建议及数据均来自我们认为可靠的资料。虽然是以诚信提供，但由于我们无法控制产品的使用条件和方法，无法对兼容性的应用提出任何建议，因此这些建议及数据仅供参考，而不作为产品保证。在任何时候，应由用户最终决定他们的生产线是否能够有效地使用。应由买方决定产品是否合适或适用特殊用途。不保证产品质量或适用性可满足任何特殊用途。我们建议潜在用户在大量使用前，首先确定我们的材料适用性和建议。